

TCL 中环新能源科技股份有限公司

关于子公司投资建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、项目尚处于筹备启动阶段，投资总额、建设工期、经济效益等均为预估数，具体数据以实际情况为准；本次项目建设过程中涉及环评、立项、规划、设计、施工等环节，尚需获得有关部门批复，项目开展存在不确定性；

2、公司本次投资项目实施过程中可能面临政策风险、市场风险、行业竞争风险等各种因素导致项目进程及效益不达预期的风险；

3、该项目总投资金额较大，公司将结合市场环境与项目实施进度，综合运用自有资金、股权融资、债权融资等方式筹措项目投资资金。项目建设周期较长，公司将结合项目进展分批投资，预期不会对当期业绩产生重大影响；

4、半导体材料产业经营目前仍处于亏损状态，本项目在推进过程中可能会面临各种技术和业务方面的风险，例如产能爬坡、客户验证等，可能存在项目未来盈利不确定性风险；

5、公司将密切关注投资事项的后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，理性投资。

一、拟投资项目概述

（一）基本情况

根据 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司中环领先半导体科技股份有限公司（以下简称“中环领先”）战略及业务发展需要，为了抓住半导体市场机遇，实现公司长期可持续发展，拟以中环领先子公司深圳中环领先半导体材料有限公司（以下简称“深圳中环领先”或“项目公司”）为主体投资建设“集成电路用半导体大硅片

深圳项目”（以下简称“深圳大硅片项目”或“项目”）。本项目投资总额预计约为 1,196,000 万元（最终投资总额以实际投资为准），其中拟以自有资金出资注册资本金为不超过总体投资额的 40%，项目总投资与实际自有资金出资的差额部分，通过项目公司股权融资、项目公司向银团贷款等符合法律的方式解决。

（二）审议程序

公司于 2026 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司投资建设项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目投资主体的基本情况

深圳中环领先作为深圳大硅片项目的投资主体，基本情况如下：

1、公司名称：深圳中环领先半导体材料有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MAKDFRP1U

3、法定代表人：王彦君

4、注册资本：5,000 万元人民币

5、注册地址：广东省深圳市光明区

6、经营范围：一般经营项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；其他电子器件制造；电子产品销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：深圳中环领先为中环领先全资子公司

三、拟投资项目的的基本情况

1、项目名称：集成电路用半导体大硅片深圳项目

2、项目主要内容：新建集成电路用半导体大硅片深圳项目，其中，重点建设抛光片、外延片，工序包括成型、线切割、研磨、热处理、抛光、清洗、外延等。建设工程包括：生产及辅助生产设施、动力设施、环保设施、安全设施、消防设施、管理设施、生活服务设施以及相应的建（构）筑物

3、项目建设期：项目实施共 60 个月，其中建设期从桩基施工到一期产能工艺设备开始试投产共计 18 个月

4、项目选址：项目总占地面积约 160 亩，选址广东省深圳市光明区，具体以《建设用地使用权出让合同》为准

5、项目总投资及资金来源：项目总投资为 1,196,000 万元，其中建设投资为 1,158,000 万元，铺底流动资金为 38,000 万元（最终投资总额以实际投资为准）。公司拟以自有资金出资注册资本金为不超过总体投资额的 40%，项目总投资与实际自有资金出资的差额部分，通过项目公司股权融资、项目公司向银团贷款等符合法律的方式解决

6、项目规划产能：规划产品包括集成电路用 12 英寸抛光片及外延片、测试片，共计 70 万片/月

四、项目的必要性及对公司的影响

1、本次投资有利于公司贴近下游市场，持续完善全产品能力，进一步提高 12 英寸产品产能规模以及逻辑、存储用半导体硅片产品结构占比。

2、本次规划建设深圳大硅片项目，项目建设投资金额较大，为统筹整体资金规划，保障项目建设有序推进，优化项目资本结构、减轻公司资金投入压力，后续将结合市场环境项目实施进度，综合运用自有资金、股权融资、债权融资等方式筹措项目投资资金。

3、本次项目的投资规模为计划数，公司将根据政策情况、市场变化和经营发展需要，逐步推进项目规划建设和投产，并在项目规划总投资范围内动态调整建设周期、实际投资总额、产品结构等，并根据项目实施进度办理项目涉及的立项备案、环评等相关手续。

五、风险提示

1、项目尚处于筹备启动阶段，投资总额、建设工期、经济效益等均为预估数，具体数据以实际情况为准；本次项目建设过程中涉及环评、立项、规划、设计、施工等环节，尚需获得有关部门批复，项目开展存在不确定性；

2、公司本次投资项目实施过程中可能面临政策风险、市场风险、行业竞争风险等各种因素导致项目进程及效益不达预期的风险；

3、该项目总投资金额较大，公司将结合市场环境项目实施进度，综合运用自有资金、股权融资、债权融资等方式筹措项目投资资金。项目建设周期较长，公司将结合项目进展分批投资，预期不会对当期业绩产生重大影响；

4、半导体材料产业经营目前仍处于亏损状态，本项目在推进过程中可能会面临各种技术和业务方面的风险，例如产能爬坡、客户验证等，可能存在项目未来盈利不确定性风险；

5、公司将密切关注投资事项的后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，理性投资。

六、授权事项

为保证本次投资建设项目的顺利实施，董事会授权公司经营层及其授权人士根据政策情况、市场变化和经营发展需要，逐步推进项目规划建设和投产，并在项目规划总投资范围内动态调整建设周期、实际投资总额、产品结构等，以及根据项目实施进度办理项目涉及的立项备案、环评等相关手续与文件。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第七届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议决议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日